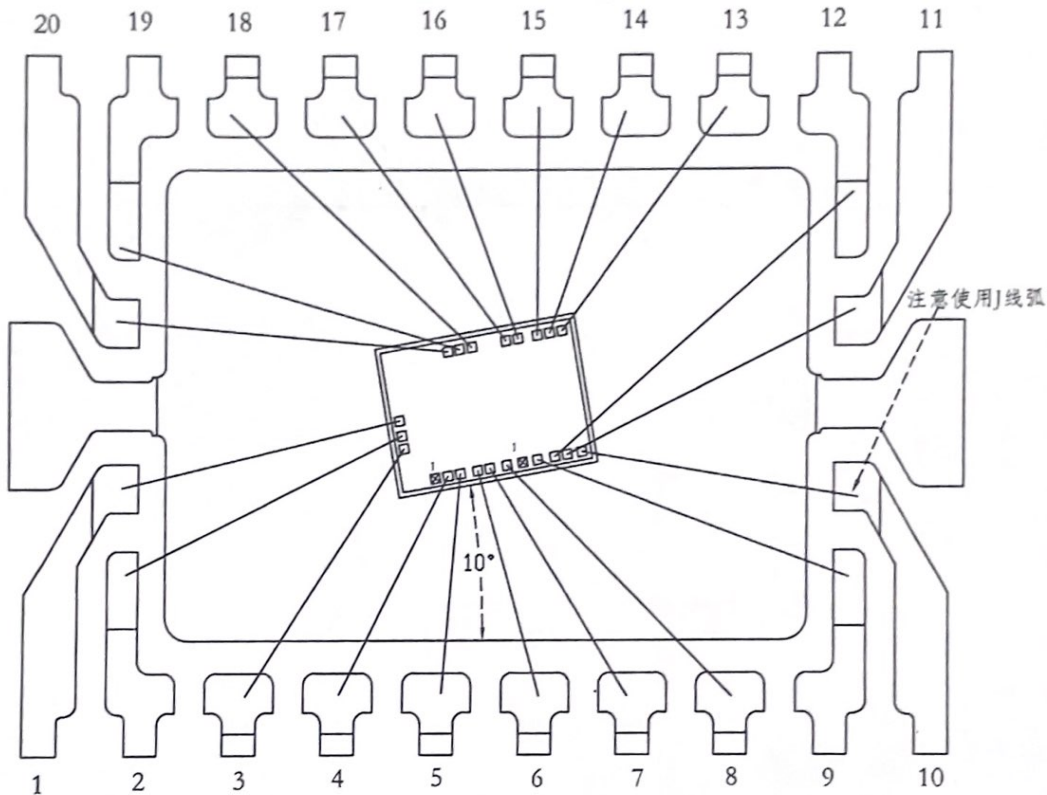
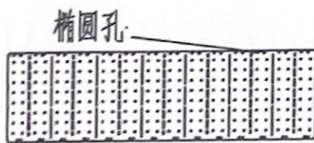
 池州华宇电子科技股份有限公司 CHIZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 焊线图纸 Bonding Diagram				客户代码 Customer No.	008	图号 Drawing No.	HY-PX-008-749 A	
产品名称 Product Name				HS5146_M5		封装形式 PKG Type	TSSOP20	
焊线类型 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	焊料牌号(绿色环保) Compound Type (Green)	LF 载体尺寸 LF Pad Size	
合金丝 Ag	20	20	42069	2570	1485	优选(Preferred): EME-GANAY 备选(Optional):	TSSOP20L-SR (118X165mm ²) (300X4200um ²)	
客户图号 Customer drawing NO.								



封装传递方向(载片):
L/F Direction (D/A):



实物图:
Chip photo:

特殊说明 Special Instructions:

DB注意:
芯片居中放置并逆时针旋转10°;
WB注意:
1. 数字为不打线pad点个数;

说明 Remarks	贴片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPD (μm ²)	最小焊盘间距 Min BPP (μm)	焊盘厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	贴片线宽度 Solder line (μm)	晶圆尺寸 Wafer size (12 inch/300 mm)	是否处 Leadless (0 Lead/0.1)	封装厚度 (mm)
A 芯: DIE A	导电胶 (conductive) 8502	DB6	1264*904(μm ²) 49.76*35.59(mil ²)	60*60	82	2	是/Yes	60	8	否/NO	200
B 芯: DIE B											
C 芯: DIE C											
编制 Prepared by	刘修林 2024.4.25		制图日期 Create Date	2024/4/25		生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature 刘修林 2024.04.26				
研发审核 R&D Check	刘修林 2024.4.25		产品工程审核 PE Check			批准 Approved by					

*温馨提示: 图纸为产品下线生产的唯一依据, 请认真确认, 我司依据您提供的图纸生产, 如因图纸错误产生不可估量损失, 谢谢!
warm tips: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as drawing mistakes, which will produce inevitable loss. Thank you